

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2026-004

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于公司半导体晶圆载具等产品获得客户采购份额的 自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）研发生产的 12 英寸 FOUP、HWS 及配套辅材等半导体耗材产品，近日获得某国内主流晶圆厂客户 2026 年超半数的采购份额，合计金额超千万元人民币，目前鼎龙蔚柏已启动批量交付的准备工作，具体交付时间及数量将依据客户实际下达的订单情况逐步推进。

本次订单份额的落地，是鼎龙蔚柏继 2024 年底晶圆载具产品通过客户验证并开始批量供货后，首次获得某国内主流晶圆厂客户超半数的年度采购订单份额。这一突破意味着鼎龙蔚柏在终端客户层面获得了充分信任，不仅标志着鼎龙蔚柏具备稳定量产与持续供货能力，也预示着鼎龙蔚柏将在 2026 年实现规模化生产并形成持续释放的产能。此次订单的顺利获取，将有效推动公司半导体耗材业务的市场拓展进程，进一步建立在 12 英寸晶圆载具领域的竞争优势，显著提升鼎龙蔚柏作为国产半导体晶圆载具核心供应商的行业知名度与品牌影响力。

二、鼎龙蔚柏半导体耗材产品的进展情况

鼎龙蔚柏在半导体生产领域主要为客户提供半导体晶圆载具、光罩载具和洁净包装物等产品，致力于为半导体制程提供全方位、高精度的承载、运输产品。目前在研产品 7 个，其中 FOUP、FOSB、HWS、光罩盒、超洁净桶等多个产品进入国内多家主流晶圆厂、硅片厂、封测厂、掩膜版厂、湿电子化学品厂的“小

批量验证”阶段。

三、对公司的影响及风险提示

上述订单的执行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因订单的执行而对客户形成依赖。

订单执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致订单延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日